

2021-2027年中国集成电路 封装行业深度分析与投资前景报告

报告目录及图表目录

智研数据研究中心 编制

www.abaogao.com

一、报告报价

《2021-2027年中国集成电路封装行业深度分析与投资前景报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.abaogao.com/b/tongxun/998477DZI3.html>

报告价格：印刷版：RMB 8000 电子版：RMB 8000 印刷版+电子版：RMB 8200

智研数据研究中心

订购电话：400-600-8596(免长话费) 010-80993963

海外报告销售：010-80993963

传真：010-60343813

Email：sales@abaogao.com

联系人：刘老师 谭老师 陈老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

集成电路封装在电子学金字塔中的位置既是金字塔的尖顶又是金字塔的基座。说它同时处在这两种位置都有很充分的根据。从电子元器件（如晶体管）的密度这个角度上来说，IC代表了电子学的尖端。但是IC又是一个起始点，是一种基本结构单元，是组成我们生活中大多数电子系统的基础。同样，IC不仅仅是单块芯片或者基本电子结构，IC的种类千差万别（模拟电路、数字电路、射频电路、传感器等），因而对于封装的需求和要求也各不相同。本文对IC封装技术做了全面的回顾，以粗线条的方式介绍了制造这些不可缺少的封装结构时用到的各种材料和工艺。

智研数据研究中心发布的《2021-2027年中国集成电路封装行业深度分析与投资前景报告》共八章。首先介绍了集成电路封装行业市场发展环境、集成电路封装整体运行态势等，接着分析了集成电路封装行业市场运行的现状，然后介绍了集成电路封装市场竞争格局。随后，报告对集成电路封装做了重点企业经营状况分析，最后分析了集成电路封装行业发展趋势与投资预测。您若想对集成电路封装产业有个系统的了解或者想投资集成电路封装行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第1章：国内集成电路封装行业进展背景

1.1集成电路封装行业定义及种类

1.1.1集成电路封装行业定义

1.1.2集成电路封装行业产品大类

1.1.3集成电路封装行业特性预测

（1）行业周期性

（2）行业地区性

（3）行业季节性

1.1.4集成电路封装行业在集成电路产业中的地位预测

1.2集成电路封装行业政策环境条件预测

1.2.1行业管理体制

1.2.2行业相关政策

- (1) 《电子信息产业调整和振兴规划》
- (2) 《集成电路产业“十三五”进展规划》
- (3) 发改委加大对集成电路行业的支持力度
- (4) 科技部重点支持集成电路重点专项
- (5) 《进一步鼓励软件产业和集成电路产业进展的若干政策》
- (6) 海关支持软件产业和集成电路产业进展有关政策规定和措施

1.3集成电路封装行业经济环境条件预测

1.3.1国际宏观经济动态预测及分析

- (1) 国际宏观经济现状
- (2) 国际宏观经济分析

1.3.2中国宏观经济动态预测及分析

- (1) GDP增长情况预测
- (2) 工业经济增长预测
- (3) 固定资产投资情况
- (4) 社会消费品零售总额
- (5) 进出口总额及其增长
- (6) 货币供应量及其--daikuan
- (7) 居民消费者价格指数

1.4集成电路封装行业技能环境条件预测

1.4.1集成电路封装技能演进预测

1.4.2集成电路封装形式应用领域

1.4.3集成电路封装工艺流程预测

1.4.4集成电路封装行业新技能走势

第2章：国内集成电路产业进展预测

2.1集成电路产业进展趋势

2.1.1集成电路产业链简介

2.1.2集成电路产业进展现状透析

- (1) 行业进展势头良好
- (2) 行业技能水平快速提升
- (3) 行业竞争力仍有待加强

(4) 产业结构进一步优化

2.1.3 集成电路产业地区进展格局预测

(1) 三大地区集聚进展格局业已形成

(2) 整体呈现“一轴一带”的分布特征

(3) 产业整体将“有聚有分，东进西移”

2.1.4 集成电路产业面临的进展机遇

(1) 产业政策环境条件进一步向好

(2) 战略性新兴产业将加速进展

(3) 资本市场将为公司融资提供更多机会

2.1.5 集成电路产业面临的主要问题

(1) 范围小

(2) 创新不足

(3) 价值链整合不够

(4) 产业链不完善

2.1.6 集成电路产业“十三五”进展分析

2.2 集成电路设计业进展趋势

2.2.1 集成电路设计业进展概况

2.2.2 集成电路设计业进展特征

(1) 产业范围持续扩大

(2) 质量上升数量下降

(3) 公司范围持续扩大

(4) 技能能力大幅提升

2.2.3 集成电路设计业进展隐忧

2.2.4 集成电路设计业新进展战略

2.2.5 集成电路设计业“十三五”进展分析

2.3 集成电路制造业进展趋势

2.3.1 集成电路制造业进展现状透析

(1) 集成电路制造业进展总体概况

(2) 集成电路制造业进展主要特征

(3) 集成电路制造业范围及财务指标预测

1) 集成电路制造业范围预测

2) 集成电路制造业盈利能力预测

3) 集成电路制造业营销能力预测

4) 集成电路制造业偿债能力预测

5) 集成电路制造业进展能力预测

2.3.2 集成电路制造业经济指标预测

(1) 集成电路制造业主要经济效益影响因素

(2) 集成电路制造业经济指标预测

(3) 不同范围公司主要经济指标比重变化情况预测

(4) 不同性质公司主要经济指标比重变化情况预测

(5) 不同区域公司经济指标预测

2.3.3 集成电路制造业供需平衡预测

(1) 全国集成电路制造业供给情况预测

1) 全国集成电路制造业总产值预测

2) 全国集成电路制造业产成品预测

(2) 全国集成电路制造业需求情况预测

1) 全国集成电路制造业销售产值预测

2) 全国集成电路制造业销售收入预测

(3) 全国集成电路制造业产销率预测

2.3.4 集成电路制造业“十三五”进展分析

第3章：国内集成电路封装行业进展预测

3.1 半导体行业进展预测

3.1.1 半导体行业指数对比预测

(1) 费城半导体指数与道琼斯指数

(2) 台湾电子零组件指数与台湾加权指数

(3) CSRC电子行业指数与沪深0指数

3.1.2 世界半导体产销预测

(1) 世界半导体产值情况

(2) 世界半导体销售情况

3.1.3 世界半导体行业主要公司情况

(1) 世界半导体10强

(2) 世界领先半导体情况

3.1.4 国内半导体行业进展概况

3.1.5 半导体设备BB值预测

3.1.6 半导体行业景气分析

3.1.7 半导体行业进展状况

(1) 产业链向专业化分工转型

(2) 综合厂商向轻资产转型

(3) 封装环节产值逐年成长

(4) 封装环节外包也是状况

3.2 集成电路封装行业进展预测

3.2.1 集成电路封装行业范围预测

3.2.2 集成电路封装行业进展现状透析

3.2.3 集成电路封装行业利润水平预测

3.2.4 大陆厂商与业内领先厂商的技能比较

3.2.5 集成电路封装行业影响因素预测

(1) 有利因素

(2) 不利因素

3.2.6 集成电路封装行业进展状况及未来分析

(1) 进展状况预测

(2) 未来分析

3.3 集成电路封装类专利预测

3.3.1 专利预测样本构成

(1) 数据库选择

(2) 检索方式

3.3.2 封装类专利预测

(1) 专利公开年度状况

(2) 中国外专利公开状况对比

(3) 中国专利公开主要省市分布

(4) IPC技能种类状况分布

(5) 主要权利人分布情况

3.4 集成电路封装过程部分技能问题探讨

3.4.1 集成电路封装开裂产生理由预测及对策

(1) 封装开裂的影响因素预测

(2) 管控影响开裂的因素的方法预测

3.4.2 集成电路封装芯片弹坑问题产生理由预测及对策

(1) 产生芯片弹坑问题的因素预测

(2) 预防芯片弹坑问题产生的方法

第4章：国内集成电路封装行业市场需求预测

4.1 集成电路市场预测

4.1.1 集成电路市场范围

4.1.2 集成电路市场结构预测

(1) 集成电路市场产品结构预测

(2) 集成电路市场应用结构预测

4.1.3 集成电路市场竞争格局

4.1.4 集成电路中国市场自给率

4.1.5 集成电路市场进展分析

4.2 集成电路封装行业需求预测

4.2.1 计算机领域对行业的需求预测

(1) 计算机市场进展现状

(2) 集成电路在计算机领域的应用

(3) 计算机领域对行业需求的拉动

4.2.2 消费电子领域对行业的需求预测

(1) 消费电子市场进展现状

(2) 集成电路在消费电子领域的应用

(3) 消费电子领域对行业需求的拉动

4.2.3 通信设备领域对行业的需求预测

(1) 通信设备市场进展现状

(2) 集成电路在通信设备领域的应用

(3) 通信设备领域对行业需求的拉动

4.2.4 工控设备领域对行业的需求预测

(1) 工控设备市场进展现状

(2) 集成电路在工控设备领域的应用

(3) 工控设备领域对行业需求的拉动

4.2.5 汽车电子领域对行业的需求预测

(1) 汽车电子市场进展现状

(2) 集成电路在汽车电子领域的应用

(3) 汽车电子领域对行业需求的拉动

4.2.6其他应用领域对行业的需求预测

第5章：国内集成电路封装行业市场竞争预测

5.1集成电路封装行业竞争结构波特五力模型预测

5.1.1现有竞争者之间的竞争

5.1.2关键要素的供应商议价能力预测

5.1.3消费者议价能力预测

5.1.4行业潜在进入者预测

5.1.5替代品风险剖析

5.2集成电路封装行业国际竞争格局预测

5.2.1国际集成电路封装市场总体进展趋势

5.2.2国际集成电路封装市场竞争趋势预测

5.2.3国际集成电路封装市场进展状况预测

(1) 封装技能的高密度、高速和高频率以及低成本

(2) 主板材料的变化状况

5.2.4跨国公司在华市场竞争力预测

(1) 台湾日月光集团竞争力预测

1) 公司进展简介

2) 公司经营情况预测

3) 公司主营产品及应用领域

4) 公司市场地区及行业地位预测

5) 公司在国内市场投资布局情况

(2) 美国安靠 (Amkor) 企业竞争力预测

1) 公司进展简介

2) 公司经营情况预测

3) 公司主营产品及应用领域

4) 公司市场地区及行业地位预测

5) 公司在国内市场投资布局情况

(3) 台湾矽品企业竞争力预测

1) 公司进展简介

2) 公司经营情况预测

3) 公司主营产品及应用领域

4) 公司市场地区及行业地位预测

5) 公司在国内市场投资布局情况

(4) 新加坡STATS-ChipPAC企业竞争力预测

1) 公司进展简介

2) 公司经营情况预测

3) 公司主营产品及应用领域

4) 公司市场地区及行业地位预测

5) 公司在国内市场投资布局情况

(5) 力成科技股份有限企业竞争力预测

1) 公司进展简介

2) 公司经营情况预测

3) 公司主营产品及应用领域

4) 公司市场地区及行业地位预测

5) 公司在国内市场投资布局情况

(6) 飞思卡尔企业竞争力预测

1) 公司进展简介

2) 公司经营情况预测

3) 公司主营产品及应用领域

4) 公司市场地区及行业地位预测

5) 公司在国内市场投资布局情况

(7) 英飞凌科技企业竞争力预测

1) 公司进展简介

2) 公司经营情况预测

3) 公司主营产品及应用领域

4) 公司市场地区及行业地位预测

5) 公司在国内市场投资布局情况

5.3集成电路封装行业中国竞争格局预测

5.3.1中国集成电路封装行业竞争格局预测

5.3.2中国集成电路封装行业集中度预测

(1) 行业销售收入集中度预测

(2) 行业利润集中度预测

(3) 行业工业总产值集中度预测

5.3.3国内集成电路封装行业国际竞争力预测

第6章：国内集成电路封装行业产品市场预测

6.1集成电路封装行业BGA产品市场预测

6.1.1BGA封装技能水平

6.1.2BGA产品主要应用领域

6.1.3BGA产品需求拉动因素

6.1.4BGA产品市场范围预测

6.1.5BGA产品市场未来预测

6.2集成电路封装行业SIP产品市场预测

6.2.1SIP封装技能水平

6.2.2SIP产品主要应用领域

6.2.3SIP产品需求拉动因素

6.2.4SIP产品市场范围预测

6.2.5SIP产品市场未来预测

6.3集成电路封装行业SOP产品市场预测

6.3.1SOP封装技能水平

6.3.2SOP产品主要应用领域

6.3.3SOP产品市场进展现状

6.3.4SOP产品市场未来预测

6.4集成电路封装行业QFP产品市场预测

6.4.1QFP封装技能水平

6.4.2QFP产品主要应用领域

6.4.3QFP产品市场进展现状

6.4.4QFP产品市场未来预测

6.5集成电路封装行业QFN产品市场预测

6.5.1QFN封装技能水平

6.5.2QFN产品主要应用领域

6.5.3QFN产品市场进展现状

6.5.4QFN产品市场未来预测

6.6 集成电路封装行业MCM产品市场预测

6.6.1 MCM封装技能水平概况

(1) 概念简介

(2) MCM封装种类

6.6.2 MCM产品主要应用领域

6.6.3 MCM产品需求拉动因素

6.6.4 MCM产品市场进展现状

6.6.5 MCM产品市场未来预测

6.7 集成电路封装行业CSP产品市场预测

6.7.1 CSP封装技能水平概况

(1) 概念简介

(2) CSP产品特征

(3) CSP封装种类

(4) CSP封装工艺流程

6.7.2 CSP产品主要应用领域

6.7.3 CSP产品市场进展现状

6.7.4 CSP产品市场未来预测

6.8 集成电路封装行业其他产品市场预测

6.8.1 晶圆级封装市场预测

(1) 概念简介

(2) 产品特征

(3) 主要应用领域

(4) 市场范围与主要供应商

(5) 未来预测

6.8.2 覆晶/倒封装市场预测

(1) 概念简介

(2) 产品特征

(3) 市场未来

6.8.D 封装市场预测

(1) 概念简介

(2) 封装方法

(3) 进展现状与未来

第7章：国内集成电路封装行业主要公司经营预测

7.1 集成电路封装公司进展总体趋势预测

7.1.1 集成电路封装行业制造商工业总产值排名

7.1.2 集成电路封装行业制造商销售收入排名

7.1.3 集成电路封装行业制造商利润总额排名

7.2 集成电路封装行业领先公司个案预测

7.2.1 飞思卡尔半导体（国内）有限企业经营情况预测

（1）公司进展简况预测

（2）公司产销能力预测

（3）公司盈利能力预测

（4）公司营销能力预测

（5）公司偿债能力预测

（6）公司进展能力预测

（7）公司产品结构及新产品动向

（8）公司销售渠道与网络

（9）公司经营趋势优劣势预测

7.2.2 威讯联合半导体（北京）有限企业经营情况预测

（1）公司进展简况预测

（2）公司产销能力预测

（3）公司盈利能力预测

（4）公司营销能力预测

（5）公司偿债能力预测

（6）公司进展能力预测

（7）公司产品结构及新产品动向

（8）公司销售渠道与网络

（9）公司经营趋势优劣势预测

7.2.3 江苏长电科技股份有限企业经营情况预测

（1）公司进展简况预测

（2）主要经济指标预测

（3）公司盈利能力预测

（4）公司营销能力预测

- (5) 公司偿债能力预测
- (6) 公司进展能力预测
- (7) 公司组织架构预测
- (8) 公司产品结构及新产品动向
- (9) 公司销售渠道与网络
- (10) 公司经营趋势优劣势预测
- (11) 公司投资兼并与重组预测
- (12) 公司最新进展动向预测

7.2.4上海松下半导体有限企业经营情况预测

- (1) 公司进展简况预测
- (2) 公司产销能力预测
- (3) 公司盈利能力预测
- (4) 公司营销能力预测
- (5) 公司偿债能力预测
- (6) 公司进展能力预测
- (7) 公司产品结构及新产品动向
- (8) 公司销售渠道与网络
- (9) 公司经营趋势优劣势预测

7.2.5深圳赛意法微电子有限企业经营情况预测

- (1) 公司进展简况预测
- (2) 公司产销能力预测
- (3) 公司盈利能力预测
- (4) 公司营销能力预测
- (5) 公司偿债能力预测
- (6) 公司进展能力预测
- (7) 公司产品结构及新产品动向
- (8) 公司销售渠道与网络
- (9) 公司经营趋势优劣势预测
- (10) 公司最新进展动向预测

第8章：国内集成电路封装行业投资预测及意见

8.1集成电路封装行业投资特性预测

8.1.1 集成电路封装行业进入壁垒

(1) 技能壁垒

(2) 资金壁垒

(3) 人才壁垒

(4) 严格的客户认证制度

8.1.2 集成电路封装行业盈利模式

8.1.3 集成电路封装行业盈利因素

8.2 集成电路封装行业投资兼并与重组预测

8.2.1 集成电路封装行业投资兼并与重组整合概况

8.2.2 国际集成电路封装公司投资兼并与重组整合预测

8.2.3 中国集成电路封装公司投资兼并与重组整合预测

(1) 通富微电企业投资兼并与重组预测

(2) 华天科技企业投资兼并与重组预测

(3) 长电科技企业投资兼并与重组预测

8.2.4 集成电路封装行业投资兼并与重组整合状况预测

8.3 集成电路封装行业投融资预测

8.3.1 电子进展基金对集成电路产业的扶持预测

(1) 电子进展基金对集成电路产业的扶持情况

(2) 电子进展基金对集成电路产业的扶持意见

8.3.2 集成电路封装行业融资成本预测

8.3.3 半导体行业资本支出预测

8.4 集成电路封装行业投资意见

8.4.1 集成电路封装行业投资机会预测

8.4.2 集成电路封装行业投资风险剖析

8.4.3 集成电路封装行业投资意见

(1) 投资地区意见

(2) 投资产品意见

(3) 技能升级意见

部分图表目录

图表1：2015-2019年全球经济增长率及分析（季度环比折年率，%）

图表2：2015-2019年国内中国生产总值同比增长速度（单位：%）

图表3：2015-2019年国内范围以上工业增加值增速（单位：%）

图表4：2019年全国固定资产投资（不含农户）同比增速（单位：%）

图表5：2019年国内社会消费品零售总额同比增速（单位：%）

图表6：2015-2019年国内货物进出口总额（单位：亿美元）

图表7：2015-2019年国内广义货币（M2）增长速度（单位：%）

图表8：2015-2019年国内居民消费者价格指数同比增长情况（单位：%）

图表9：封装技能的演进

图表10：各种集成电路封装形式应用领域

图表11：集成电路封装工艺流程

图表12：集成电路产业链示意图

图表13：2015-2019年国内集成电路销售额增长状况（单位：亿元，%）

图表14：2015-2019年国内集成电路产量及增长情况（单位：万块，%）

图表15：2015-2019年国内半导体销售额增长状况（单位：亿元，%）

图表16：国内集成电路产业长三角区域分布概况

图表17：2019年国内集成电路进口统计（单位：亿个；美元/个）

图表18：2015-2019年国内集成电路产业销售情况（单位：亿元；%）

图表19：2019-4年集成电路制造业范围预测（单位：家，人，万元）

图表20：2019-4年国内集成电路制造业盈利能力预测（单位：%）

图表21：2019-4年国内集成电路制造业营销能力预测（单位：次）

图表22：2019-4年国内集成电路制造业偿债能力预测（单位：%，倍）

图表23：2019-4年国内集成电路制造业进展能力预测（单位：%）

图表24：2015-2019年集成电路制造业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%）

图表25：2015-2019年不同范围公司数量比重变化状况图（单位：%）

图表：2015-2019年不同范围公司资产总额比重变化状况图（单位：%）

图表：2015-2019年不同范围公司销售收入比重变化状况图（单位：%）

图表：2015-2019年不同范围公司利润总额比重变化状况图（单位：%）

图表29：2015-2019年不同性质公司数量比重变化状况图（单位：%）

图表：2015-2019年不同性质公司资产总额比重变化状况图（单位：%）

更多图表见正文……

详细请访问：<http://www.abaogao.com/b/tongxun/998477DZI3.html>